

FX16 免洗液态助焊剂

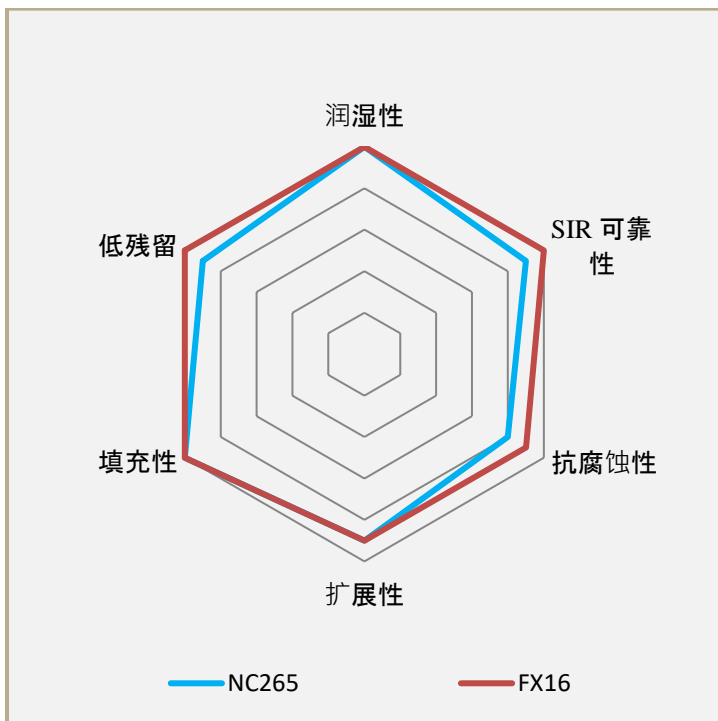
特点

- ▶ 无卤化物/无卤素
- ▶ J-STD-004A/B 分类为 ROLO
- ▶ 低焊后残留
- ▶ 迅速润湿所有含铅和无铅合金
- ▶ 符合 IPC-A-610F 要求
- ▶ 高 SIR 可靠性
- ▶ 工艺窗口宽

描述

FX16 免清洗助焊剂设计提供卓越的焊接性能，即使不加热的情况下，焊后残留很少，即使不加热也具有电气安全性。FX16 可用于点对点的选择性波峰焊和托盘化波峰焊。FX16 提供快速润湿性能和 PTH 通孔填充，并减少常见的焊接缺陷，比如桥接、拉尖和锡球。FX16 具有持久的活化系统，耐受高工艺温度，可满足加热应用和延长焊料接触时间的需求。

特性



处理&储存

参数	时间	温度
密封保质期	1 年	室温

FX16 在室温下可密封存储一年。不要靠近火源或易燃物品，避免光照，以免降低产品质量。FX16 可以直接使用，不需要搅拌。不要将使用过和未使用的产品混合装在相同的容器内，请重新密封已开容器。储存条件范围 4-40° C (40-100° F)。

应用

FX16 的应用方式为喷雾，刷和蘸。FX16 可以从容器中取出直接使用，不用稀释。当喷洒助焊剂时，需将助焊剂适当覆盖，以达到并保持均匀一致。干燥助焊剂覆盖起始时建议每平方英寸涂抹 500-1500 毫克。

工艺指导

将热电偶贴附于 PCB 的上表面，其温度应该在 80-140° C (175-285° F) 之间。确保助焊剂在接触波峰前完全烘干，预热未干的助焊剂会引起飞溅。少量出烟是正常现象。推荐的接触时间取决于波峰配置、炉温、合金类型和热装配。典型的推荐值为 3 - 7 秒。请访问 <http://www.aimsolder.com/technical-support-contacts> 联系 AIM 技术支持以获得工艺协助。

清洁

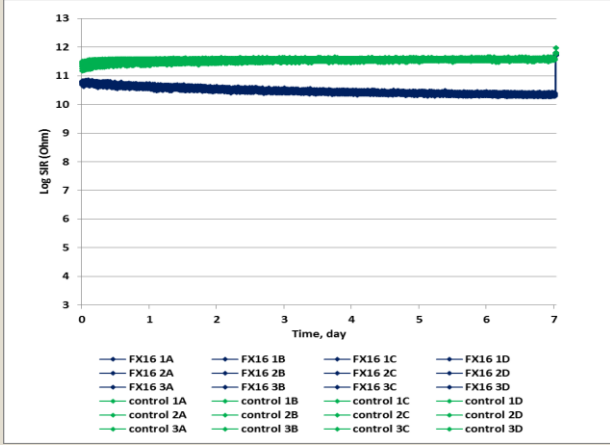
FX16 回流后残留物可保留在在组件上，无需清洗。在必须清洁的情况下，AIM 已与其工业合作伙伴确保 FX16 残留物可使用普通除焊剂清洁。请联系 AIM 以获得清洁兼容信息。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。不要在未核准容器内处理任何有害物质。

测试数据小结

名称	测试方法	结果	图像
IPC 助焊剂分类	J-STD-004	ROLO	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1	ROLO	
名称	测试方法	结果	图像
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.00% Cl: 0.00%	
定量卤化物, 铬酸银	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物, 氟化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟	

名称	测试方法	结果	图像
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	所有测试模 板上的测量 都超过 100MΩ	
助焊剂固定含量, 非挥发性测定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	2.7 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	16.0 典型值	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.80 典型值	
pH (1% 溶液 /水)	ASTM D5464 ASTM G51	5.26 典型值	
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	通过	
润湿性	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过	